

TOSHIBA

2018年度 連結決算概要

東芝メモリホールディングス株式会社

2019年5月13日

注意事項

2017年4月1日に株式会社東芝からメモリ事業を会社分割し（旧）東芝メモリ株式会社（以下「旧TMC」）が発足しました。2018年6月1日にBain Capitalを軸とする企業コンソーシアムにより組成される株式会社Pangea（以下「Pangea」または「新TMC」）が旧TMCを買収したのち、2018年8月1日に新TMCが旧TMCを吸収合併し、社名は東芝メモリ株式会社となりました。また、2019年3月1日に単独株式移転により東芝メモリ株式会社を完全子会社とする東芝メモリホールディングス株式会社を設立しました。

将来に関する記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定および所信に基づくものであり、多様なリスクや不確実性（経済動向、市場需要、半導体業界における激しい競争等がありますが、これらに限られません。）により、実際の結果とは異なる可能性があるのご承知おきください。また、当社は本資料上の将来予想に関する記述について更新する義務を負うものではありません。

本資料に記載されるメモリ市場の見通し等に関する情報は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成しているものであり、当社がその真実性、正確性、合理性及び網羅性について保証するものではありません。

なお、本資料は、当社の2018年度連結決算情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。

NVMelはNVM Express, Inc.の商標です。その他、本文に掲載の製品名やサービス名は、それぞれ各社が登録商標または商標として使用している場合があります。

業績概要(1)

[億円]	19年3月期 3Q (新TMC)	19年3月期 4Q (TMCHD ⁽²⁾)	対前四半期	18年3月期 (旧TMC)	19年3月期		
					① 18/4-18/5 (旧TMC) ⁽³⁾	② 18/6-19/3 (TMCHD) ⁽²⁾⁽⁶⁾	①+② (単純合算) ⁽⁷⁾
売上高	3,106	2,470	▲636	12,294	1,894	10,745	12,639
営業利益	540	▲284	▲824	4,568	704	459	1,163
マージン	17%	▲11%	▲29pt	37%	37%	4%	9%
当期純利益	299	▲193	▲492	7,186	489	116	605
マージン	10%	▲8%	▲17pt	58%	26%	1%	5%
減価償却費	971	1,008	37	1,791	361	3,190	3,551
PPA影響 ⁽⁴⁾	▲272	▲261	+11	0	0	▲2,272	▲2,272
法人税等 ⁽⁵⁾	▲113	207	+320	▲2,590	207	▲78	129

- 19年3月期3Q、4Q及び18年3月期は各社の連結財務諸表、19年3月期の①、②は連結計算書類を基に作成、全てIFRSベース、①及び①+②は未監査
- 2019年3月1日に単独株式移転により完全子会社となった新TMCの連結計算書類を引き継いで作成
- Pangealによる買収前、東芝連結時の旧TMCの連結計算書類
- Pangealによる旧TMCの買収に伴い発生したPPAによる営業利益への影響額（詳細はP5参照）
- 18年3月期の法人税等：当期法人税756億円＋法人税調整額▲3,346億円（2017年4月のメモリ事業の非適格分割により発生した税務上ののれんに対する4年分の税効果（3,104億円）を含む）
- 18/4-19/3のTMCHDの連結計算書類の数値であり、18/4-18/5におけるPangealの資金調達に係る損益を含むが、同期間に実質的に事業を行っていた旧TMCの損益を含まないため、上記のとおり表示
- 単純合算数値であり、表中の前年度の数値と厳密な比較をするために必要な各種調整は行っていない

ハイライト (1/3)

足元の実績及び動向

	3Q	4Q
GB物量 (QoQ)	10%台前半の 増加	1桁台半ばの 減少
GB単価 (QoQ)	20%台半ばの 下落	20%台半ばの 下落

- データセンター向け需要が弱かったことに加え、スマートフォン向け需要も季節性要因にて弱含み
- 15 nm NAND製品の減産を実施したためGB物量は減少
- BiCS FLASH™の生産比率は90%以上に上昇（2019年3月単月、Bitベース）
- GB単価は2018年後半からの下落傾向が続く

東芝メモリホールディングス株式会社の設立

- 東芝メモリ株式会社を含む傘下会社の管理・監督機能を拡充しガバナンスの強化を図ると共に、M&Aを含むグループの経営戦略の策定、資源配分、リスク管理、資金調達等の機能を担い、グループ全体の企業価値向上を企図し、2019年3月1日に東芝メモリホールディングスを設立

製品開発・技術開発

- QLC技術を用いた96層積層プロセスの「BiCS FLASH™」の開発（2018/7/20）
- 96層積層プロセスの「BiCS FLASH™」を搭載したSSD「XG6シリーズ」の出荷（2018/7/24）
- 96層積層プロセスの「BiCS FLASH™」とコントローラーをSingle Packageに納めた、NVMe™ SSD「BG4シリーズ」の出荷（2019/1/9）
- 高速・大容量SSD向けPAM4を用いたブリッジチップの技術開発（2019/2/21）
- 「BiCS FLASH™」を搭載した車載機器向け組み込み式フラッシュメモリの出荷（2019/3/26）

ハイライト (2/3)

PPA影響概要

PPA影響

	(億円)
PPA実施前の暫定のれん残高	7,841
(PPA実施)	
①棚卸資産	-) 1,388
②固定資産	-) 4,295
③繰延税金負債	+) 1,720
PPA実施後ののれん残高	3,878

PPA実施による営業利益／当期利益への影響

(億円)	1Q (6月単月)	2Q	3Q	4Q	19年3月期 通期
①棚卸資産の増加に伴う コスト増	▲500	▲888	-	-	▲1,388
②固定資産の増加に伴う 償却費増等	▲83	▲268	▲272	▲261	▲884
PPA影響（営業利益）	▲583	▲1,156	▲272	▲261	▲2,272
税効果	+177	+350	+82	+79	+688
PPA影響（当期利益）	▲406	▲806	▲190	▲182	▲1,584

- 旧TMCの支配獲得日（2018年6月1日）における同社の資産の公正価値を基礎とした取得金額の配分手続（Purchase Price Allocation/PPA）を19年3月期第3四半期に完了。これにより、会計上の①棚卸資産が1,388億円、②固定資産が4,295億円それぞれ増加（2018年6月1日に遡って修正⁽¹⁾）
- 19年3月期におけるPPA影響は右上表の通り。また今後の②PPAによる固定資産の増加に伴う償却費用増等については、20年3月期から22年3月期まで各年1,000億円程度、それにより95%以上の償却等が完了する見込み

1. (株)東芝の公表内容とは会計基準の違いから一部差異あり

ハイライト (3/3)

足元の市場動向及び見通し

- 供給側では、メモリ各社が供給の絞り込み（設備投資の削減／減産）を実施。需要側においては、GB単価の下落によるSSDのHDD置換えの加速やスマートフォンのメモリ搭載量の増加に加え、データセンター向け需要の回復等により、2019年後半以降在庫水準が適正值に向けて改善していくとの予想が一般的
- 19年3月期における当社の設備投資は、市況動向を踏まえ昨年度比で設備投資額（発注ベース）を大幅に抑制しつつ、コスト削減及び事業競争力の強化に向けた必要な投資として四日市工場第6製造棟でのBiCS FLASH™ 96層製品の立ち上げ、及び東芝メモリ岩手（岩手県北上市）において新製造棟の建設を実施

END